

2026 年 3 月期 第 1 四半期 決算説明会 Q&A

■ 質問一覧

- Q1 CY2025 および CY2026 前半（1~6 月）の WFE 市場見通しを見直した要因を、アプリケーション別に教えてほしい。
- Q2 CY2026 後半に市場成長が加速する要因は？ CY2026 の WFE 市場想定は変わらないか？
- Q3 今後、顧客の生産性向上によりさらに WFE 市場成長が鈍化する懸念があるのか？
- Q4 WFE 市場の見通しの変化については、CY2025 では前年比プラス 5%成長、FY2026 では前年比マイナス 5%成長と理解したが、この差は CY と FY の 3 カ月の違いによるものか？
- Q5 CY2025 の WFE 市場の見通しは大きく変わっていない一方で、TEL の FY2026 下期業績予想を下方修正した。これは、TEL が市場シェアを落としているということなのか、あるいは CY2026 の 1~3 月の見通しが大きく変わったということか？また、決算説明会資料の 13 ページに業績予想修正の背景として、顧客の投資計画の変動の事例をいくつか挙げているが、定量的にはどの項目の影響が大きいのか？
- Q6 FY2026 下期の業績予想を 7 月の決算発表のタイミングで修正したということは、CY2026 の 1~3 月の顧客の設備投資の見通しがかなり明確になっているということか？
- Q7 四半期の売上高の観点では、CY2026 の 1~3 月期に底を打つという理解でいいか？
- Q8 FY2026 のアプリケーション別売上予想について、4 月 30 日の前回決算説明会の時点からどのアプリケーションが大きく変化しているのか？
- Q9 中国の WFE 投資は、CY2025 後半から CY2026 前半にかけて減少するか？
- Q10 中国の新興半導体メーカーの歩留まり改善による新たな設備投資の計画や、新規に参入する半導体メーカーが投資を行うような動向はあるか？
- Q11 中国を除く WFE 市場シェアについてコメントをいただきたい。また、TEL がシェアを失っている分野はあるか？
- Q12 現中期経営計画について、達成見通しに変化はあるか？現中期経営計画を発表した時から、外部環境などが大きく変わっていることを勘案すると、中期経営計画を刷新する可能性はあるのか、それとも現中期経営計画をやり切る方針なのか、考えを教えてほしい。

■ Q&A

Q1 CY2025 および CY2026 前半の WFE*¹ 市場見通しを見直した要因を、アプリケーション別に教えてほしい。

A1 CY2025 はロジック/ファウンドリで先端顧客の一部の投資を見直した。NAND は弱含んだが構成比率が大きいいため全体への影響は限定的。顧客の生産技術の向上や需給バランスの見直しにより、CY2026 前半は投資が一時的に抑えられる見込み。

[▲Top](#)

Q2 CY2026 後半に市場成長が加速する要因は？ CY2026 の WFE 市場想定は変わらないか？

A2 一番のけん引役は AI サーバー向け先端ロジックと HBM*² の増加。GPU 搭載数と HBM の DRAM 積層数が大幅に拡大し、デバイス規模が増大する。CY2027 の AI サーバー向けの投資は CY2026 後半から行われると予測しており、CY2026 の WFE 市場見通しは現在精査中。

[▲Top](#)

Q3 今後、顧客の生産性向上によりさらに WFE 市場成長が鈍化する懸念があるのか？

A3 半導体市場は CY2030 に約 1 兆ドルに達すると予想され、全体の成長傾向は変わらず、需要自体は減少していない。顧客は需給バランスや利益率を重視し、生産性や歩留まりの向上によりコスト削減が進んでいる。WFE 市場は健全に成長しており、中長期的には技術革新の進展を確認できた。今後さらなる成長が期待できる。

[▲Top](#)

Q4 WFE 市場の見通しの変化については、CY2025 では前年比プラス 5% 成長、FY2026 では前年比マイナス 5% 成長と理解したが、この差は CY と FY の 3 カ月の違いによるものか？

A4 そのとおり。CY2025 の WFE 市場については、ひとつは円高の影響で日本製装置のドル換算売上が影響し \$3B 上昇。あとの \$2B は先端ロジックの前倒し等によるもの。デバイスの需要とともに CY2026 に向けて WFE 市場が成長していくという見方は全く変わっていない。なお、今回の業績予想修正は、顧客の歩留まり改善による生産性向上、NAND 顧客を中心とした収益性を意識した需給バランスの最適化、一部ロジック顧客の先行投資型から着実な投資スタイルへの切り替えなどの影響によるもの。顧客の設備投資の案件が消滅したのではなく、半年ぐらいのずれが生じたと考えている。

[▲Top](#)

Q5 CY2025 の WFE 市場の見通しは大きく変わっていない一方で、TEL の FY2026 下期業績予想を下方修正した。これは、TEL が市場シェアを落としているということなのか、あるいは CY2026 の 1~3 月の見通しが大きく変わったということか？

また、決算説明会資料の 13 ページに業績予想修正の背景として、顧客の投資計画の変動の事例をいくつか挙げているが、定量的にはどの項目の影響が大きいのか？

A5 CY2026 の 1~3 月の見通しが大きく変わったということになる。もともと CY2026 の WFE 市場が 2 桁成長するとみていたため、FY2026 の Q4 から売上が伸びていくと考えていたが、顧客における生産性の向上や設備投資戦略の変化があった。当社のシェアについては、当社が参入している領域ではシェアは確保できており、競合各社との納入タイミングのずれやプロダクトミックスによる業績の違いはあるかもしれないが、業績予想の修正はシェアが下がることによるものではない。

資料 13 ページの事例では、NAND における需給バランスを慎重に見た投資計画の変更・中国新興半導体メーカーにおけるレガシー投資の減少・先端ロジック顧客の設備投資見直しの 3 点の影響が特に大きいと考えている。

[▲Top](#)

Q6 FY2026 下期の業績予想を 7 月の決算発表のタイミングで修正したということは、CY2026 の 1~3 月の顧客の設備投資の見通しがかなり明確になっているということか？

A6 顧客の投資戦略の変化や決算報告等で発表されている内容を反映したもののご理解いただきたい。資本市場との対話をしっかり実施したいと考え、CY2026 前半の顧客の設備投資の動向に変化がみえ、当社の業績にも影響が出る兆候が表れたタイミングで公表させていただいた。

[▲Top](#)

Q7 四半期の売上高の観点では、CY2026 の 1~3 月期に底を打つという理解でいいか？

A7 いつが底となるかは精査が必要だが、CY2026 の 1~3 月期か、あるいは 4~6 月期だと考えている。ただし、CY2027 の後半に予定されている最新の AI サーバー向け半導体のことを考慮すると、急激な回復の可能性も考えられ、見極めをしっかりとやっていきたい。

[▲Top](#)

Q8 FY2026 のアプリケーション別売上予想について、4 月 30 日の前回決算説明会の時点からどのアプリケーションが大きく変化しているのか？

A8 決算説明会資料 15 ページで示したとおり、FY2026 下期の SPE 新規装置売上予想は、前回の 1 兆 1,000 億円から、今回 8,800 億円に下方修正した。非メモリの構成比率は 59%と前回から変更ないが、絶対額は減少。これは一部のロジック顧客の投資計画の見直しを反映した。不揮発性メモリは、構成比率、絶対額ともに前回予想から減少するが、これは NAND メーカーによる需給バランスを注視した投資計画の調整を反映した。

[▲Top](#)

Q9 中国の WFE 投資は、CY2025 後半から CY2026 前半にかけて減少するか？

A9 中国は顧客の数が非常に多く、短期的なトレンドを見通すことは難しいが、年間を通しての中国 WFE 市場規模は CY2025 で\$45B 程度で、CY2026 も同規模とみている。

[▲Top](#)

Q10 中国の新興半導体メーカーの歩留まり改善による新たな設備投資の計画や、新規に参入する半導体メーカーが投資を行うような動向はあるか？

A10 現時点ではその動向は見られない。歩留まり向上が新たな投資につながる場合には、まず既存装置の稼働率が上がることでパーツ・サービスの売上増加が考えられるが、今のところその兆候は見られていない。

[▲Top](#)

Q11 中国を除く WFE 市場シェアについてコメントをいただきたい。また、TEL がシェアを失っている分野はあるか？

A11 TEL の成長における重点領域と位置付けている先端領域において、シェアは落としていないと考えている。複数の外部調査会社によると、CY2024 の WFE 市場成長率は 1 桁成長だったが、TEL の売上成長率は米ドル換算で+23%と、円安が進行する中で、非常にポジティブな結果だった。

[▲Top](#)

Q12 現中期経営計画について、達成見通しに変化はあるか？現中期経営計画を発表した時から、外部環境などが大きく変わっていることを勘案すると、中期経営計画を刷新する可能性はあるのか、それとも現中期経営計画をやり切る方針なのか、考えを教えてください。

A12 現在、見直しを行うことは考えていない。ただし、今回発表した通り CY2026 の見通しは変化しており、中期経営計画の目標を達成する時期は遅れる可能性もある。一方、様々な地政学リスクや、インフレによる物価高騰などの逆風もある中、過去 5 年で売上総利益率を 6%ポイント程度改善した。また、注力する領域で着実なビジネス展開ができており、シェア向上や新製品の POR^{*3} 獲得など様々な良い成果が得られている。今後の技術革新への期待も不変であり、将来に対する成長投資も引き続き行っていく方針に変わりはない。

[▲Top](#)

*1 WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体前工程製造装置。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用する製造装置。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

*2 HBM (High Bandwidth Memory) : 高帯域幅メモリ

*3 POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定
FY2026 は 2025 年 4 月～2026 年 3 月の会計年度を指しています。

本内容は質疑応答のサマリーです。スライドに同期した音声配信は[こちら](#)から。